

证券代码：301013

证券简称：利和兴

深圳市利和兴股份有限公司

2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	利和兴 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2026 年 5 月 8 日下午 16:00—17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台”(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：林宜潘 董事会秘书：王朝阳 财务总监：贺美华 独立董事：张志杰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，就投资者关心的问题与投资者进行了沟通交流，并就投资者比较关注的问题进行了逐一回答，主要问题及回复如下：</p> <p>1.公司年报提到，2026 年将重点拓展半导体、光模块、液冷、服务器 AI 算力、数字能源、MLCC 等多个业务方向。但从现金</p>

流看, 2025 年公司经营活动现金流和投资活动现金流均为净流出, 主要依靠筹资活动补充资金; 2026 年一季度经营活动现金流仍为 -5862.20 万元, 同时短期借款、应收账款和存货均有所增加。请问在当前资金链相对紧张、融资需求上升的情况下, 公司如何保障上述多个业务方向能够按计划推进并按期兑现?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司将通过多方面举措保障业务按计划推进。一方面: 优化资金管理, 加紧催收应收账款, 合理规划存货以避免积压, 并在内部灵活调配资金, 确保重点业务资金优先供给; 另一方面: 深挖客户合作潜力, 凭借与主要客户的合作基础争取更多订单, 稳定资金流, 同时借此提升在金融机构的信用评级以便利融资。此外, 充分释放技术优势, 发挥在各业务方向的技术长处打造优质产品, 快速占领市场加速资金回笼; 并全力推进在研项目完成, 力争实现量产与销售, 增加收入以缓解资金压力。感谢您的关注!

2.公司 2026 年一季度营业收入同比增长 116.98%, 主要原因之一是智能制造类产品发出商品验收增加。请问本次发出商品验收增加是前期项目在一季度集中验收带来的阶段性收入确认, 还是公司智能制造业务的订单交付和验收节奏已经出现持续改善? 管理层如何判断一季度收入增长在后续季度的可持续性?

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司 2026 年一季度智能制造类业务的订单交付和验收节奏确有所改善, 但市场环境复杂多变, 行业竞争激烈, 公司会持续优化运营, 积极应对各种挑战。感谢您的关注!

3.公司此前表示, 入股赛伯宸半导体是公司加码半导体行业的重要举措, 有助于公司深入半导体产业链。请问截至目前, 赛伯宸半导体自身业务发展情况如何? 其在产品研发、客户拓展、订单获取、产能建设或市场化落地方面是否已有可以披露的阶段性进展? 此外, 除入股赛伯宸半导体外, 公司目前在半导体设备

零部件、半导体测试设备、精密结构件加工等半导体相关领域还有哪些具体布局或推进计划？

答：尊敬的投资者，您好！目前赛伯宸半导体在 DRAM 测试业务方面努力积累技术，积极对接三星等头部企业的相关业务，但成效尚需时间验证。半导体领域发展机遇与挑战并存，除现有布局外，不排除公司未来继续通过投资并购等方式寻找优质标的，完善在半导体设备零部件、测试设备等方面的布局，深入半导体产业链，但具体举措需结合市场情况谨慎决策。感谢您的关注！

4.公司2025年年报提出，2026年将重点拓展半导体、液冷、光模块、AI算力服务器新业务方向，并计划并购发展速度处于10-100区间的高成长优质标的来拓展新业务，请问目前重点筛选标的集中在上述哪些板块？项目尽调、推进进度如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司长期密切关注主业上下游优质资产的投资并购机会，以及新兴产业及赛道的投资布局契机；后续如实施相关投资并购规划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

5.2025年相比2024年公司新增了哪些核心新产品？对应下游应用场景、目标市场以及市场空间分别是什么

答：尊敬的投资者，您好！同比2024年，2025年公司智能装备类业务以数字能源、服务器（AI算力）等老化测试产品增长较大，具体业绩情况请关注公司在指定媒体披露的定期报告。感谢您的关注！

6.公司参股40%的浙江赛伯宸半导体，主营DRAM芯片测试修复、存储检测设备以及配套技术服务。三星、SK海力士为赛伯宸的终端客户。请问利和兴母公司是否与三星、SK海力士存在直接业务往来？另按规划2026年公司向赛伯宸提供交易不超过2亿

元，该目标偏乐观还是保守？正常经营下赛伯宸合理应收区间大概是多少？

答：尊敬的投资者，您好！目前赛伯宸半导体在 DRAM 测试业务方面努力积累技术，积极对接三星等头部企业的相关业务，但成效尚需时间验证。具体业绩情况请关注公司在指定媒体披露的定期报告。感谢您的关注！

7.公司通过龙华区政府公示，联合欧盛自动化拿下高端半导体研发生产基地项目，项目固定资产投资不低于 4.4 亿元，投资额较大。请问项目后续拿地、建设资金如何规划？主要资金来源是定增、自有资金还是银行融资？是否存在资金压力？

答：尊敬的投资者，您好！目前该项目仅为遴选公示阶段，后续公司将根据项目具体进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

8.公司与摩尔线程合作的电容业务，对应市场规模有多大？未来能否为公司带来确定性业绩增量？

答：尊敬的投资者，您好！具体业绩情况请关注公司在指定媒体披露的定期报告。感谢您的关注！

9.公司比亚迪车规级 VMLCC 项目，当前研发、认证、订单落地的最新进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！利和兴电子元器件公司的车规级 MLCC 产品已于 2025 年 3 月完成了 AEC-Q200 标准认证，目前处于客户验证阶段。感谢您的关注！

10.你好，林董。根据深圳市政府发布的消息，利和兴参与的半导体设备及自动化设备研发生产基地是否为定增取消的项目，下一步针对这个项目公司如何筹备资金？这个项目对接的是新凯来的业务还是华为的？

	<p>答：尊敬的投资者，您好！目前该项目仅为遴选公示阶段，后续公司将根据项目具体进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！</p> <p>11.你好，林董。以往数次研报中提到的华为液冷超充业务目前是什么状况？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司液冷相关业务主要服务于公司大客户，主要产品为液冷超充相关的测试设备；公司将密切关注市场变化，深入客户需求，把握市场机遇。感谢您的关注！</p> <p>12.你好，董秘。请问四月份 mlcc 业务的产能利用率是多少？公司能够维持盈亏平衡的点位大概是多少？比亚迪的车规级验证什么时候能够批量供货？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！目前 MLCC 产能利用率较高，具体经营情况请关注公司在指定媒体披露的定期报告。感谢您的关注！</p> <p>13.你好，董秘。今年华为的业务量如何？今天还拓展了哪些新的合作，能否介绍一下？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！涉及客户信息，因有保密协议不便透露，感谢您的关注！</p>
附件清单	无
日期	2026 年 5 月 8 日